暖通空调产业技术创新联盟

暖通空调联盟 字〔2021〕01 号

绿色　安全　节能

关于举办“第四届数据中心冷却节能与新技术应用发展高峰论坛”的通知

各相关单位：

随着物联网、云计算、5G 的快速发展，全球范围内掀起数据中心建设热潮。然而，数据中心不仅耗能巨大，也面临着碳排放的压力。实现数据中心的低碳化、绿色化，成为行业可持续发展的重要方向。

为推动数据中心冷却节能技术交流，暖通空调产业技术创新联盟、中国建筑科学研究院有限公司、中国移动通信集团设计院有限公司、中讯邮电咨询设计院有限公司、华信咨询设计研究院有限公司、CDCC&中数智慧信息技术研究院、湖南大学等单位拟定于 2021 年 5 月在北京联合举办**“第四届数据中心冷却节能与新技术应用发展高峰论坛”。**欢迎大家积极参与！

一、组织机构

主办单位：暖通空调产业技术创新联盟
中国建筑科学研究院有限公司

协办单位：中国移动通信集团设计院有限公司
中讯邮电咨询设计院有限公司
华信咨询设计研究院有限公司
CDCC&中数智慧信息技术研究院
湖南大学
中国建筑设计研究院有限公司
上海邮电设计咨询研究院有限公司
广东省邮电规划设计院有限公司
中通服咨询设计研究院有限公司

西安工程大学
国家建筑工程技术研究中心
建科环能科技有限公司

支持单位： 中国建筑学会暖通空调分会
中国制冷学会空调热泵专业委员会
中国建筑节能协会暖通空调/地源热泵专业委员会

二、会议时间、地点

1.会议时间：2021 年 5 月

2.会议地点：北京（具体地点待定）

三、参会对象

云服务商、运营商、数据中心用户、科研院所、高等院校、设计单位、设备供应商、工程商、运维企业等从事 IDC 行业领域的专业、学者、科研、管理、技术人员。

四、会议注册及报名

1.会议注册费：本次会议免收会议注册费，交通、食宿费用自理。

2.参会报名：请参会代表于 4 月 25 日前扫描二维码报名或填写“参会回执表”发至会议筹备组。

报名二维码

五、会务筹备组

联系人：李　炜　13681555746　010-64693285
何远嘉　18611786335　010-64693287
王东青　13901017552　010-64517224

会议邮箱：chvac2013@126.com

六、筹办动态

会议筹备进展信息请关注：CAHVAC 微信公众号或中国暖通空调网（www.chinahvac.com.cn）。

附件：参会回执表

暖通空调产业技术创新联盟
2021 年 2 月 26 日

附件

第四届数据中心冷却节能与新技术应用发展高峰论坛参会回执表

会议时间：2021 年 5 月 **会议地点：北京**

单位名称					
通讯地址				邮编	
联 系 人		联系电话		Email	
姓　　名	性别	职务/职称	电话	手机	Email
住宿酒店	是否预订住宿酒店：　□是　□否				
对行业发展和技术应用关心的内容					

注：请于 4 月 25 日前将此表发至邮件 chvac2013@126.com。